

Descrizione del prodotto

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012.
Spessore deve essere. 050uM oltre 3-6uM nichel.

Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

L1-----Hoz

-PP 7Mil-

- -

L2-----1

-COre 9,05 mil-

L3-----1

- -

-PP 7mil-

L4-----Hoz

Definizioni livello:

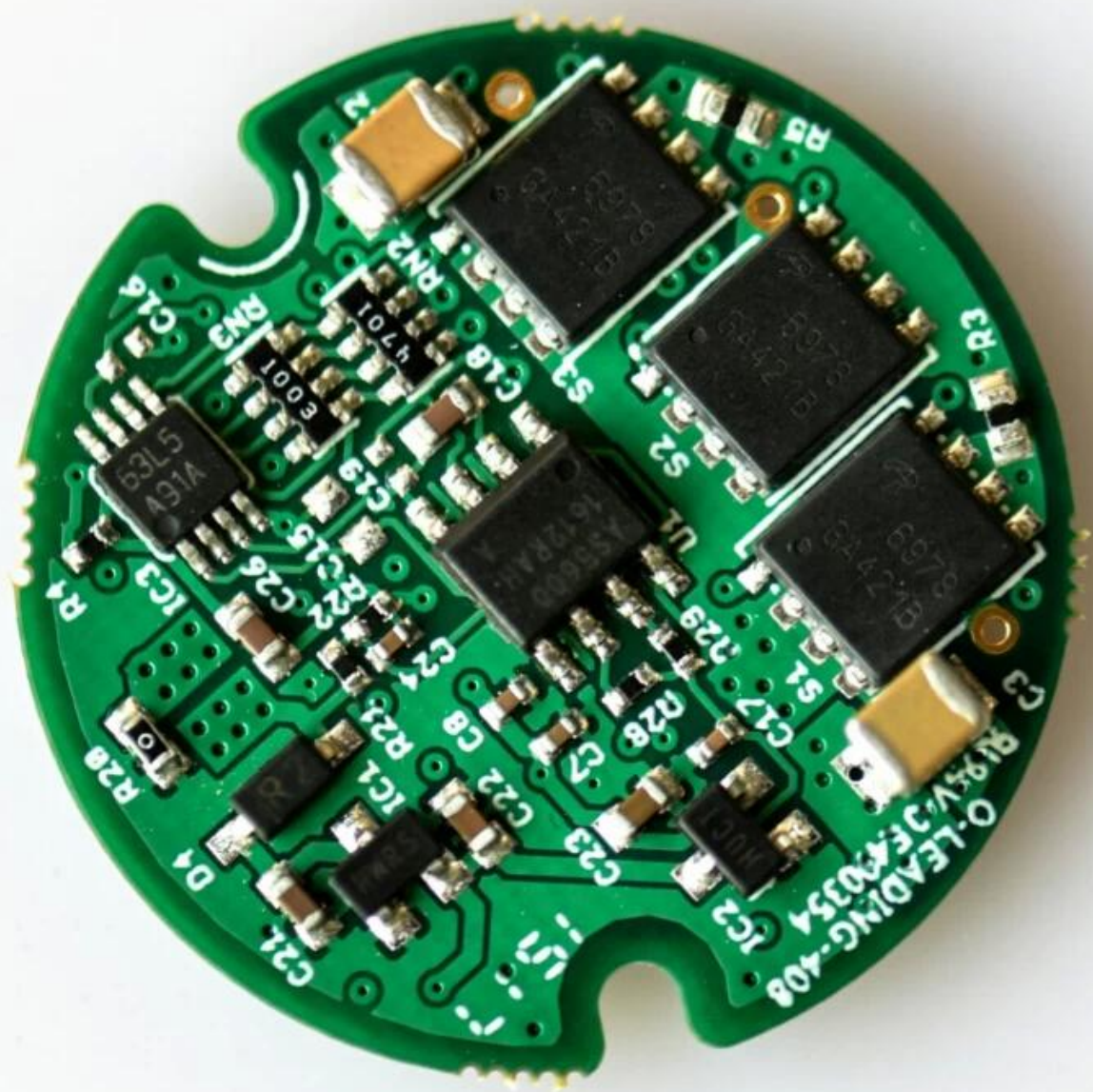
- *. GCMT-Top maschera di rivestimento conforme
- *. GTP-pasta superiore della saldatura
- *. GTO-serigrafia superiore
- *. GTS-Top soldermask
- *. GTL-strato superiore

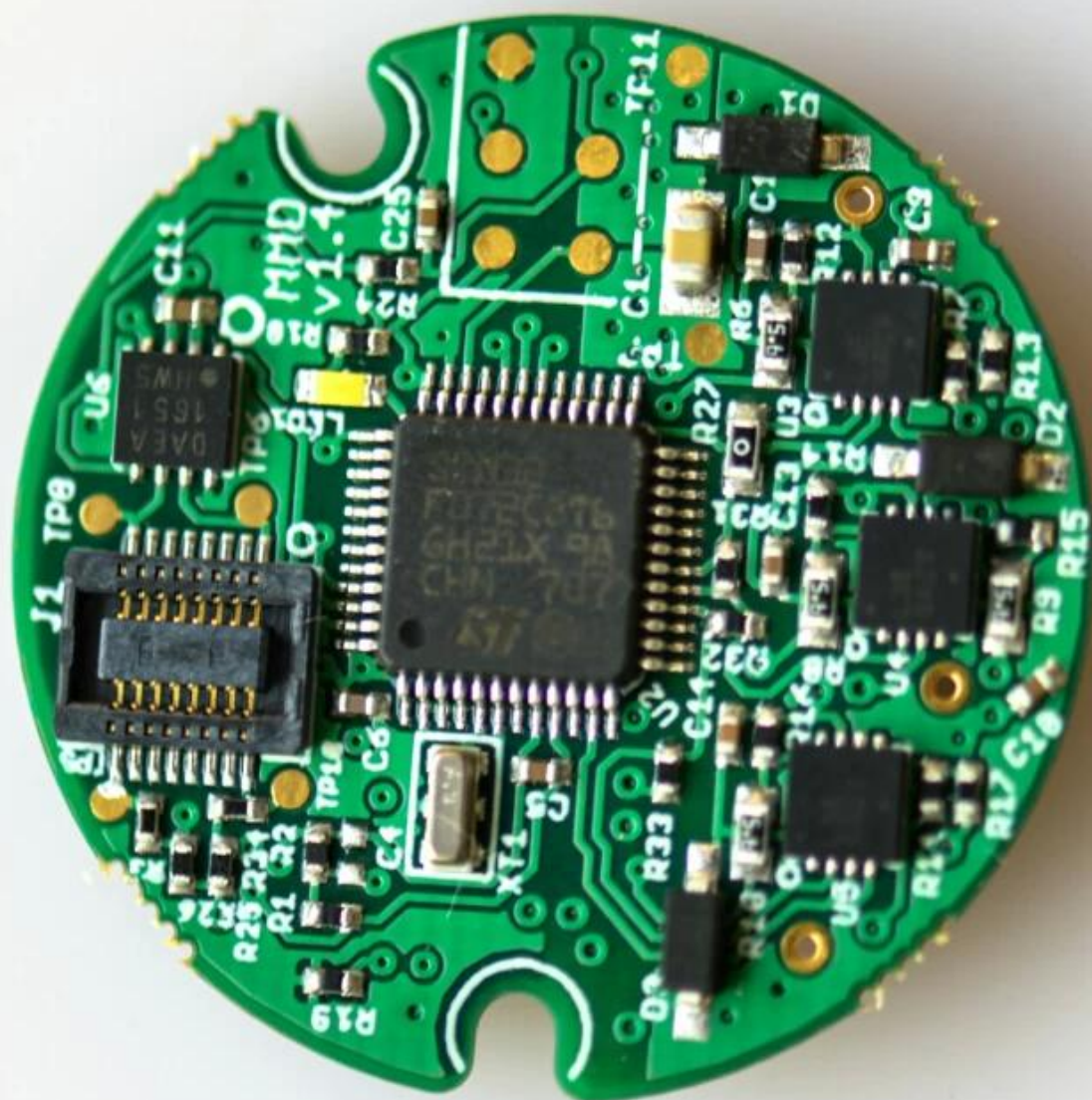
- *. G2L-livello segnale interno 1

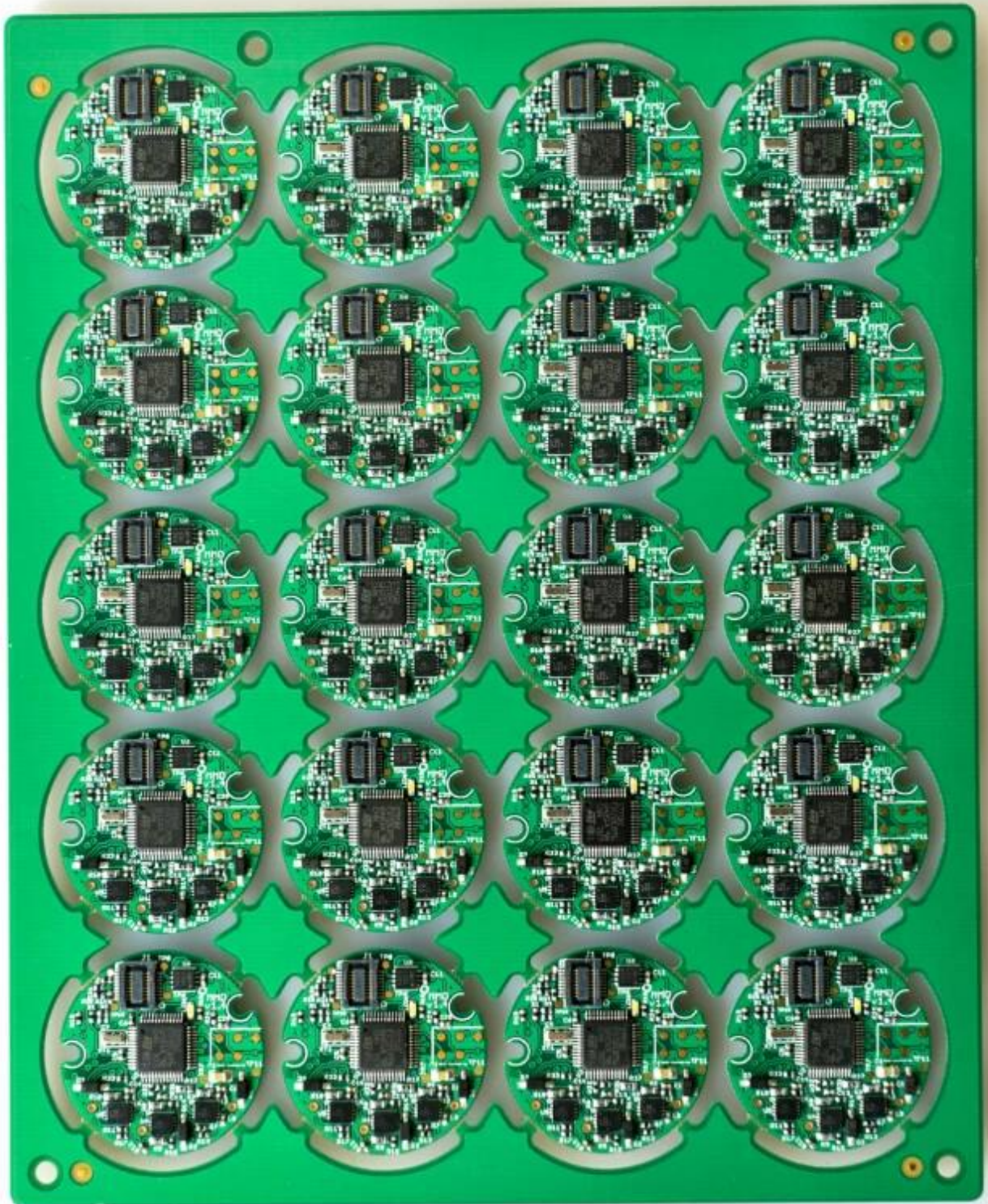
=====

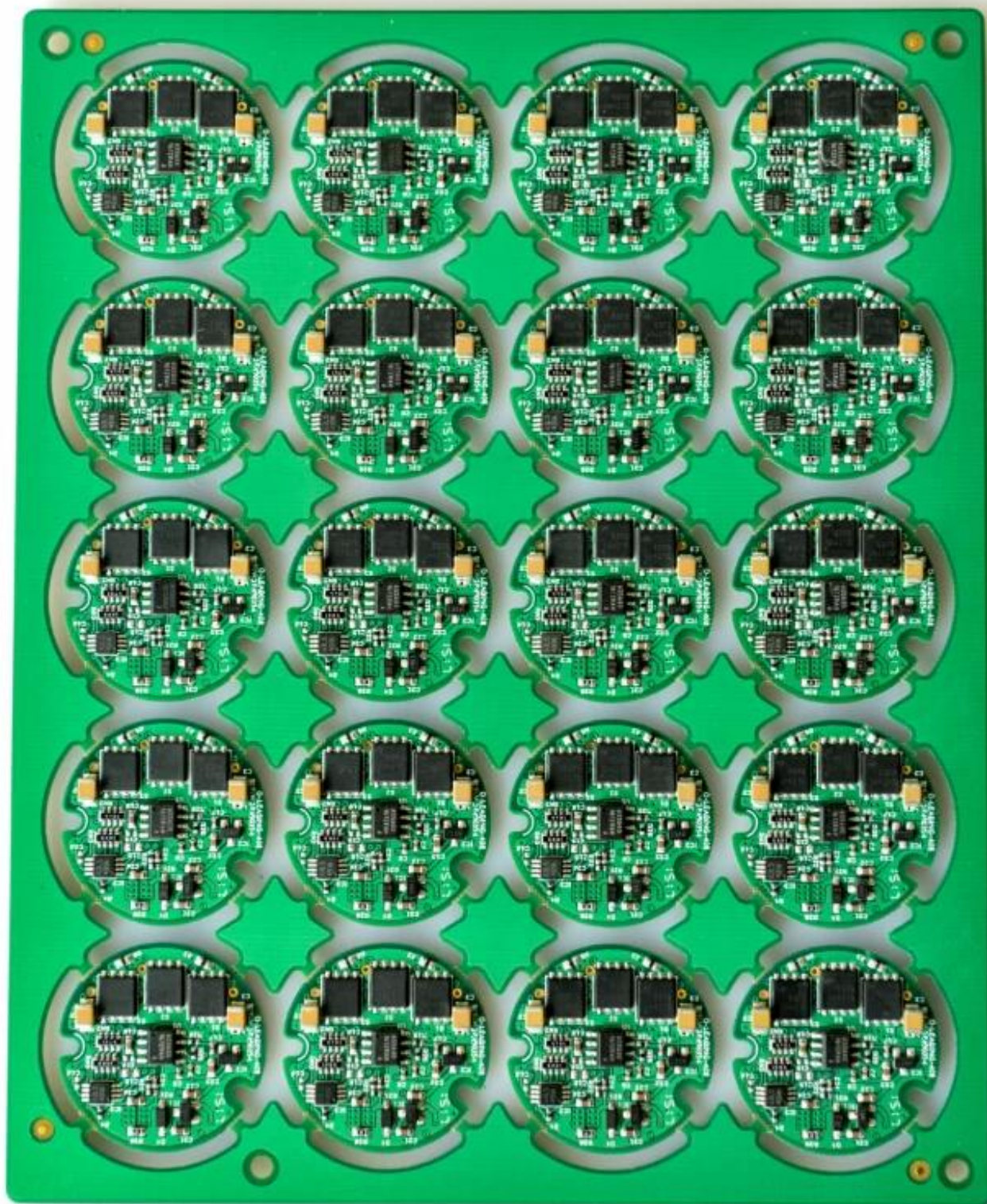
- *. G3L-livello segnale interno 2

- *. GBL-strato inferiore
- *. GBS-fondo soldermask
- *. GBO-serigrafia inferiore
- *. GBP-Bottom pasta di saldatura
- *. GCMB-Bottom maschera di rivestimento conforme









[Quick Turn PCB stampato circuito di bordo, HDI PCB stampato circuito di bordo, Circuito stampato Fornitore](#)